

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成24年7月19日(2012.7.19)

【公開番号】特開2010-56128(P2010-56128A)  
 【公開日】平成22年3月11日(2010.3.11)  
 【年通号数】公開・登録公報2010-010  
 【出願番号】特願2008-216547(P2008-216547)  
 【国際特許分類】

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 K 1/02 J

H 0 5 K 1/02 L

【手続補正書】

【提出日】平成24年6月4日(2012.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

絶縁樹脂層の片面又は両面に金属箔を有する金属張積層体の金属箔を配線加工して得られて、いずれかを屈曲させて使用する可撓性配線基板の製造方法であって、金属箔の長手方向をM軸としたとき、M軸に対して3～87°傾けた方向に所定の線幅を有する直線状の配線を形成することを特徴とする可撓性配線基板の製造方法。

【請求項2】

M軸に対して5～85°傾けた方向に所定の線幅を有する直線状の配線を形成する請求項1に記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項3】

M軸が、実質的に金属箔の<100>軸方向である請求項1又は2に記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項4】

金属箔が圧延銅箔であり、かつ、圧延銅箔の厚み方向のX線回折で求めた(200)面の強度(I)が、微粉末銅のX線回折で求めた(200)面の強度(I<sub>0</sub>)に対してI/I<sub>0</sub>2.5であるものを用いる請求項1～3のいずれかに記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項5】

M軸が圧延銅箔の圧延方向と等しく、かつ、圧延銅箔の厚さが5～30μmである請求項4に記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項6】

絶縁樹脂層が厚さ5～50μmのポリイミド樹脂層である請求項1～5のいずれかに記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項7】

可撓性配線基板が、摺動屈曲又はスライド屈曲から選ばれたいずれかの繰り返し動作を伴うものである請求項1～6のいずれかに記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項8】

屈曲させた際の曲率半径rが0.5～2mmの範囲である請求項7に記載の可撓性配線基板の製造方法。

【請求項9】

M 軸に対して 15 ~ 75 ° 傾けた方向に所定の線幅を有する直線状の配線を形成する請求項 1 ~ 8 のいずれかに記載の可撓性配線基板の製造方法。